【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和7年7月11日(2025.7.11)

【国際公開番号】WO2024/143522
【出願番号】特願2024-567969(P2024-567969)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ 21/683(2006.01)
Ｂ３２Ｂ 27/00(2006.01)
Ｃ０９Ｊ 7/20(2018.01)
Ｃ０９Ｊ 7/38(2018.01)
Ｃ０９Ｊ 7/30(2018.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ 21/68 Ｎ
Ｂ３２Ｂ 27/00 Ｍ
Ｃ０９Ｊ 7/20
Ｃ０９Ｊ 7/38
Ｃ０９Ｊ 7/30

【手続補正書】
【提出日】令和7年4月10日(2025.4.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
１つまたは２つ以上の部品が固定された仮固定用テープの剥離方法であって、
前記仮固定用テープが、伸長性基材と前記伸長性基材の一方の面上の仮固定層とを有し、延伸により剥離可能であり、
前記仮固定層が有機フィラー及び／又は有機－無機複合フィラーを含有し、
前記部品は前記仮固定層に固定されており、延伸手段により前記仮固定用テープを少なくとも一方向に延伸して前記部品から剥離する、仮固定用テープの剥離方法。
【請求項２】
前記仮固定用テープを異なる二方向に延伸し、前記二方向が概ね９０°の角度をなす請求項１に記載の仮固定用テープの剥離方法。
【請求項３】
前記仮固定用テープを全方向に延伸する、請求項１又は２に記載の仮固定用テープの剥離方法。
【請求項４】
前記延伸手段が、前記部品と前記仮固定層との接着面に対して水平方向に張力をかける請求項１～３の何れかに記載の仮固定用テープの剥離方法。
【請求項５】
前記延伸手段が、前記部品と前記仮固定層との接着面に対して、前記部品の載置側とは反対側方向に張力をかける請求項１～４の何れかに記載の仮固定用テープの剥離方法。
【請求項６】
前記延伸手段が延伸部材を有し、前記仮固定用テープの前記部品の載置側とは反対側から前記延伸部材が前記仮固定用テープを押圧して、前記部品から前記仮固定用テープ

を剥離する、請求項１～５の何れかに記載の仮固定用テープの剥離方法。
【請求項７】
前記延伸部材は平面視上、外周部と前記外周部の内側の空洞領域とを有する円環状であり、前記外周部の表面の一部が、前記外周部の外周面に沿って回転可能な被覆部により覆われている、請求項６に記載の仮固定用テープの剥離方法。
【請求項８】
前記延伸手段により前記仮固定用テープを前記一方向に延伸したときに、延伸後の前記仮固定テープの前記一方向と概ね直交する方向の長さが、延伸前の前記仮固定テープの前記一方向と概ね直交する方向の長さに対して０．９以上である、請求項１～７の何れかに記載の仮固定用テープの剥離方法。
【請求項９】
前記仮固定用テープの前記仮固定層が、表面に形成された多数の凹部が形成された吸着層である、請求項１～８の何れかに記載の仮固定用テープの剥離方法。
【請求項１０】
前記仮固定用テープの前記仮固定層が、粘着層である、請求項１～８の何れかに記載の仮固定用テープの剥離方法。
【請求項１１】
前記仮固定用テープの５０％伸長時応力（５０％モジュラス）は、０．１５ＭＰａ～２０ＭＰａの範囲内であり、破断伸度が２００％以上、請求項１～１０の何れかに記載の仮固定用テープの剥離方法。
【請求項１２】
前記仮固定用テープの剥離時伸度が１０１％～１５００％の範囲である、請求項１～１１の何れかに記載の仮固定用テープの剥離方法。
【請求項１３】
前記部品が電子部品である請求項１～１２の何れかに記載の仮固定用テープの剥離方法。
【請求項１４】
前記部品の、前記仮固定用テープと接する面の表面積が１００ｍｍ^{2}以下である請求項１～１３の何れかに記載の仮固定用テープの剥離方法。
【請求項１５】
伸長性基材と前記伸長性基材の一方の面上の仮固定層とを有し、延伸により剥離可能である仮固定用テープの剥離に用いられる剥離部材であって、
前記仮固定層が有機フィラー及び／又は有機－無機複合フィラーを含有し、
前記仮固定用テープを保持する保持部と、前記保持部により形成された中空部と、延伸手段と、を有し、
前記保持部は、仮固定用テープが前記中空部を覆うように配置され、
前記延伸手段は、前記中空部を覆う前記仮固定用テープ面内を少なくとも一方向に延伸する機能を有する剥離部材。
【請求項１６】
前記延伸手段がロールであり、前記ロールが第１の延伸方向に配置される、請求項１５に記載の剥離部材。
【請求項１７】
前記延伸手段がロールであり、前記ロールが第１の延伸方向及び前記第１の延伸方向に対して概ね９０°の角度をなす第２の伸長方向の各方向においてそれぞれ配置される、請求項１５に記載の剥離部材。
【請求項１８】
前記延伸手段が前記中空部内で上下に駆動可能であり、前記中空部を通過して前記中空部を覆う仮固定用テープを通過方向へ押圧する延伸部材をさらに有する請求項１５に記載の剥離部材。
【請求項１９】

前記延伸部材は平面視上、外周部と前記外周部の内側の空洞領域とを有する円環状であり、前記外周部の表面の一部が、前記外周部の外周面に沿って回転可能な被覆部により覆われている、請求項１８に記載の剥離部材。

【請求項２０】

請求項１５～１９の何れかに記載の仮固定用テープの剥離部材を備える部品製造装置。

【請求項２１】

請求項１～１４の何れかに記載の仮固定用テープの剥離方法を用いて仮固定用テープ上に固定された部品を剥離する剥離工程を少なくとも有する部品の製造方法。

【請求項２２】

前記部品が電子部品である請求項２１に記載の部品の製造方法。

【請求項２３】

前記部品は、前記仮固定用テープと接する面の表面積が１００ｍｍ^{2}以下である、請求項２１又は２２に記載の部品の製造方法。

【請求項２４】

前記部品が、積層セラミックコンデンサである、請求項２１～２３の何れかに記載の部品の製造方法。